

2020-2025年中国LED封装行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2020-2025年中国LED封装行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/517239.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

LED（半导体发光二极管）封装是指发光芯片的封装，相比集成电路封装有较大不同。LED的封装不仅要求能够保护灯芯，而且还要能够透光。所以LED的封装对封装材料有特殊的要求。

从LED封装产业的发展来看，第一阶段日本、美国和欧洲等厂商依托先发的技术和设备优势，成为全球最早的LED封装产业中心；第二阶段韩国和台湾地区拥有完整的消费类电子产业链，各环节分工明确，并迅速崛起；当前处于第三阶段，中国大陆承接全球产业转移，同时受益于成本优势和旺盛的下游产品市场需求，近年来呈增长趋势，已成为世界重要的LED封装生产基地。

据统计2019年中国大陆在全球LED封装供给端的市占率达到71%，海外产能主要聚焦于车用照明等相对高端的市场需求，而通用照明、景观照明、LED显示和背光等传统应用大部分来自大陆供应商。

2016-2019全球LED封装市场占有率

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 LED封装相关概述

第一节 LED封装简介

一、LED封装作用

二、LED封装的形式

三、LED封装的工艺流程

四、LED封装对封装材料要求

第二节 LED封装的常见要素

一、LED引脚成形方法

二、LED弯脚及切脚

三、LED清洗

四、LED过流保护

五、LED焊接条件

第三节 LED封装的结构类型

- 一、封装结构的类型
- 二、引脚式封装
- 三、表面贴装封装
- 四、功率型封装
- 五、COB型封装

第二章全球LED封装行业发展现状与前景分析

第一节 2015-2019年世界LED封装业的发展总况

- 一、世界LED封装业发展规模及应用
- 二、世界LED封装企业分析
- 三、世界LED封装技术先进性分析

第二节 主要地区LED封装行业发展分析

- 一、美国LED封装行业发展分析
- 二、日本LED封装行业发展分析
- 三、韩国LED封装行业发展分析
- 四、台湾LED封装行业发展分析

第三节 全球LED封装行业发展趋势与前景

- 一、全球LED封装行业发展趋势分析
- 二、全球LED封装行业发展前景预测

第四节 全球LED封装行业发展趋势与前景

- 一、CREE（科锐）
- 二、NICHIA（日亚化学）
- 三、飞利浦（Philips）
- 四、三星LED（Samsung LED）
- 五、首尔半导体（SSC）
- 六、略

第三章 2015-2019年中国LED封装行业市场发展环境分析

第一节 2015-2019年中国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP分析
- 二、消费价格指数分析
- 三、城乡居民收入分析
- 四、社会消费品零售总额
- 五、全社会固定资产投资分析
- 六、进出口总额及增长率分析

第二节 2015-2019年中国LED封装行业政策环境分析

- 一、《LED封装工艺与生产管理》
- 二、LED 封装工艺规范
- 三、LED封装行业一揽子政策发布在即
- 四、补贴政策将出LED封装市场可期
- 五、《半导体照明节能产业发展意见》
- 六、《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》
- 七、《国家“十三五”科学和技术发展规划》

第三节 2015-2019年中国LED封装行业技术环境分析

第四章 2015-2019年中国LED封装产业整体运营现状分析

第一节 中国LED封装行业发展现状分析

- 一、中国LED封装行业发展历程
- 二、中国LED封装行业发展现状

第二节 2015-2019年中国LED封装业的发展综述

- 一、中国LED封装业发展成果
- 二、产值增长情况

随着我国经济的发展以及城市化的推进，一方面在低位照明领域、景观照明领域和耗电量大的城市道路照明、交通照明领域等率先启动的应用领域，市场正从示范应用阶段开始转向普及应用阶段，市场容量不断扩大，另一方面LED照明也开始逐渐向工业、商业、办公和家居等各个横向应用领域延伸，市场渗透面日益扩展。

在政策的拉动下，LED灯已经开始进入越来越多的家庭，已经成为世界各主要国家的主流照明方式。因此，在未来较长时期内，半导体照明市场都将迎来一个中长期爆发式增长的机遇。LED需求的扩大将带动上游LED封装行业的发展。从2015年到现在，LED封装行业产值一直保持者每年10%以上的速度增长，在2019年已经达到1130亿，根据预测2020将达到1288亿。

2015-2020年中国LED封装行业产值规模

- 三、产量增长情况
- 四、价格分析
- 五、利好因素

第三节 2015-2019年国内重要LED封装项目的建设进展

- 一、韩企投资扬州兴建LED封装基地
- 二、西安经开区LED封装线项目投产
- 三、长治高科LED封装项目竣工投产
- 四、敬亭园中园LED支架及封装项目开建

五、源力光电LED封装线正式投产

第四节 SMD LED封装

- 一、SMD LED封装市场发展简况
- 二、LED封装技术壁垒较高
- 三、SMD LED封装产能尚未过剩
- 四、SMD LED封装受益于芯片价格下降

第五节 2015-2019年中国LED封装业发展中存在的热点问题探讨

- 一、制约我国LED封装业发展的因素
- 二、国内LED封装企业面临的挑战
- 三、封装业销售额与海外企业差距明显
- 四、传统封装工艺成为系统成本瓶颈

第六节 促进中国LED封装业发展的策略

- 一、做大做强LED封装产业的对策
- 二、发展LED封装行业的措施建议
- 三、LED封装业发展需加大研发投入
- 四、我国LED封装业应向高端转型

第五章 2015-2019年中国LED封装行业市场分析

第一节 2015-2019年中国LED封装市场规模分析

- 一、2015-2019年中国LED封装行业市场规模及增速
- 二、2015-2019年中国LED封装行业市场饱和度
- 三、2020-2025年中国LED封装行业市场规模及增速预测

第二节 2015-2019年中国LED封装行业市场供需分析

- 一、2015-2019年中国LED封装行业市场需求分析
- 二、2015-2019年中国LED封装行业市场供给分析
- 三、2015-2019年中国LED封装所属行业进出口分析
- 四、2015-2019年中国LED行业价格分析

第三节 2015-2019年中国LED封装市场发展态势

- 一、中国成中低端LED封装重要基地
- 二、国内LED封装企业发展不平衡
- 三、中国LED封装市场缺乏大型企业
- 四、LED产业上游厂商涉足封装市场
- 五、台湾LED封装产能向大陆转移

第四节 中国LED封装企业分布状况

第五节 广东省LED封装业

- 一、主要特点
- 二、重点市场
- 三、发展趋势

第六章 2015-2019年中国LED封装地区市场情况分析

第一节 LED封装“东北地区”市场情况分析

- 一、2015-2019年东北地区发展情况分析
- 二、2015-2019年东北地区市场需求情况分析

第二节 LED封装“华北地区”市场情况分析

- 一、2015-2019年华北地区发展情况分析
- 二、2015-2019年华北地区市场需求情况分析

第三节 LED封装“华南地区”市场情况分析

- 一、2015-2019年华南地区发展情况分析
- 二、2015-2019年华南地区市场需求情况分析

第四节 LED封装“华东地区”市场情况分析

- 一、2015-2019年华东地区发展情况分析
- 二、2015-2019年华东地区市场需求情况分析

第五节 LED封装“西北地区”市场情况分析

- 一、2015-2019年西北地区发展情况分析
- 二、2015-2019年西北地区市场需求情况分析

第六节 LED封装“西南地区”市场情况分析

- 一、2015-2019年西南地区发展情况分析
- 二、2015-2019年西南地区市场需求情况分析

第七节 LED封装“华中地区”市场情况分析

- 一、2015-2019年华中地区发展情况分析
- 二、2015-2019年华中地区市场需求情况分析

第七章 2015-2019年中国LED封装行业技术研发进展状况

第一节 中国LED封装技术分析

- 一、LED封装产品技术
- 二、LED封装技术原理
- 三、LED封装结构及技术
- 四、国内中游上市公司各自优势
- 五、LED的封装步骤及技术要领
- 六、大功率LED封装结构及技术原理透析

七、大功率白光LED封装技术面临的挑战

第二节 中国LED封装技术发展概况

- 一、封装技术影响LED产品可靠性
- 二、中外LED封装技术的差异
- 三、中国LED业专利集中在封装领域
- 四、中国LED封装业的技术特点
- 五、LED封装技术水平不断提升
- 六、LED封装业技术研发仍需加强

第三节 LED封装关键技术介绍

- 一、大功率LED封装的关键技术
- 二、显示屏用LED封装的技术要求
- 三、固态照明对LED封装的技术要求

第八章 2015-2019年中国LED封装设备及封装材料的发展

第一节 LED封装设备市场分析

- 一、我国LED封装设备市场概况
- 二、LED封装设备国产化亟需加速
- 三、发展我国LED封装设备业的思路

第二节 LED封装材料市场分析

- 一、LED封装主要原材介绍
- 二、我国LED封装材料市场简析
- 三、部分关键封装原材料仍依赖进口
- 四、LED封装用基板材料市场走向分析
- 五、LED封装支架市场 91

第三节 国内LED封装支架市场格局分析

- 一、LED封装支架技术未来发展趋势
- 二、我国LED封装支架市场前景广阔

第九章 2015-2019年中国LED封装产业竞争新形态分析

第一节 2015-2019年中国LED封装市场竞争格局

- 一、中国采购影响世界封装市场格局
- 二、我国LED封装市场各方力量简述
- 三、国内LED封装市场竞争加剧
- 四、本土LED封装企业整合步伐加速

第二节 2015-2019年中国LED封装企业集中度分析

- 一、2015-2019年中国LED封装企业集中度分析
- 二、2019年本土LED封装企业竞争力排名
- 第三节 2020-2025年中国LED封装竞争趋势预测分析

第十章中国LED封装部分企业经营分析

- 第一节 国星光电
- 第二节 瑞丰光电
- 第三节 源磊科技
- 第四节 鸿利光电
- 第五节 雷曼光电
- 第六节 宁波升谱光电半导体有限公司
- 第七节 南京汉德森科技股份有限公司
- 第八节 大族光电
- 第九节 厦门信达
- 第十节 亿光电子

第十一章 2020-2025年中国LED封装发展趋势及前景

- 第一节 2020-2025年LED封装未来发展趋势
 - 一、功率型白光LED封装技术发展趋势
 - 二、LED封装技术将向模块化方向发展
 - 三、LED封装产业未来发展走向分析
- 第二节 2020-2025年中国LED封装市场前景展望
 - 一、我国LED封装市场发展前景乐观
 - 二、LED封装产品应用市场将持续扩张
 - 三、中国LED通用照明封装市场规模预测

第十二章 2020-2025年中国LED封装投资前景预测

- 第一节 2020-2025年中国LED封装投资概况
 - 一、LED封装行业投资特性(AK LZH)
 - 二、LED封装具有良好的投资价值
 - 三、LED封装投资环境利好
- 第二节 2020-2025年中国LED封装投资机会分析
 - 一、LED封装投资热点（LED封装、LED封装电视）
 - 二、国家节能减排衍生LED封装投资机会
- 第三节 2020-2025年中国LED封装投资风险及防范

一、技术风险分析

二、金融风险分析

三、政策风险分析

四、竞争风险分析

第四节建议

图表目录：

图表 LED封装行业产业链

图表 2015-2019年LED封装行业市场供给

图表 2015-2019年LED封装行业市场需求

图表 2015-2019年LED封装行业市场规模

图表 2015-2019年中国LED封装行业市场规模及增速

图表 2015-2019年中国LED封装行业重点企业市场份额

图表 2019年中国LED封装行业渠道结构

图表 2015-2019年中国LED封装行业需求总量

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/517239.html>